

StrataFlash, la puce 'tout en un' d'Intel

La technologie '

Multi-Level Cell d'Intel permet aux fabricants de terminaux mobiles téléphones et PDA de disposer de trois types de fonctionnalités mémoires « tout en un »: stockage de données important, mémoire RAM et exécution du code. StrataFlash Wireless Memory d'Intel se présente sous la forme d'un boîtier de 8x11mm, de conception simple, économique et de taille réduite donc, fonctionnant à 1,8 volt; l'autonomie est au rendez-vous, et avec une densité de mémoire pouvant aller jusqu'à 1Go. Le système est équipé de la broche de sortie et du logiciel de gestion de la gamme Stacked-CSP, qui lui confère une faculté d'empilement. Présenté au forum des développeurs Intel de Taïwan, StrataFlash est donc une solution économique qui pourrait envahir la prochaine génération des téléphones portables et des ordinateurs de poche sous technologie MLC de quatrième génération.